

证券代码：001399

证券简称：惠科股份

公告编号：2026-005

惠科股份有限公司

关于同意签署合作协议并对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、惠科先进封装及测试项目（以下简称“项目”“本项目”）推进需要一定建设周期，如因有关政策调整、项目核准、市场环境、前沿技术开发等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。项目二期启动需根据项目一期实施情况综合评估后确定，存在一定不确定性。合作协议中提及的产能规模为基于当前情况的阶段性预估，不构成对投资者的实质性业绩承诺。

2、先进封装及测试项目目前处于前期筹备阶段，尚未完成产线建设，未产生任何量产及营收，预计未来2-3年内，上述业务不会对公司经营业绩产生重大影响。项目后续技术路线验证、工艺开发等实施进度存在重大不确定性。

3、先进封装及测试领域技术迭代较快，客户最终技术路线选择、市场需求格局及行业竞争态势具有重大不确定性，若公司后续技术研发或客户验证进度不及预期，可能导致项目量产时间延后或预期收益调整。

4、本项目涉及公司进入新的业务领域，在高端人才引进、核心团队组建及业务管理体系搭建方面需要一定适应期，若相关进展不及预期，可能对项目整体推进效率产生阶段性影响。

5、本次公司设立全资子公司注册资本为40亿元人民币，资金来源为自有资金。公司预计将在项目公司设立后2-3年内根据项目建设进度需求分期投入，该安排预计将对公司现金流带来一定影响。

公司提醒投资者注意，上述相关风险可能导致本项目最终实现的投资回报与预期存在差异，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为延伸产业链、完善产业布局，惠科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日与杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会就开展惠科先进封装及测试项目签署《先进封装及测试项目合作协议》（以下简称“合作协议”），出资40亿元设立全资子公司浙江惠芯先进半导体有限公司（暂定名）（以下简称“项目公司”）作为项目实施主体。

公司于2026年7月17日召开第四届董事会第五次临时会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于同意签署合作协议并对外投资设立全资子公司的议案》，同意本次签署合作协议并对外投资设立全资子公司事项，并授权公司管理层或其授权代表全权负责办理本次合作相关协议签署、履行及设立全资子公司的相关事宜。

本次签署合作协议并对外投资设立全资子公司事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次对外投资事项既不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方概述

- 1、名称：杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会
- 2、统一社会信用代码：11330600MB1P89281P
- 3、负责人：景尧
- 4、地址：浙江省绍兴市柯桥区群贤西路4313号
- 5、性质：机关单位
- 6、杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：浙江惠芯先进半导体有限公司（暂定名）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：40亿元人民币，预计将在项目公司设立后2-3年内将按照项目建设进度需求分期投入

4、资金来源：自有资金

5、股权结构：公司持有项目公司100%股权

6、项目公司名称、注册地址、经营范围等信息均以工商注册登记核准为准。

四、合作协议的主要内容

公司与杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会签署合作协议的主要内容：

1、合同主体

甲方：杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会

乙方：惠科股份有限公司

2、项目概况

（1）投资单位：乙方在杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区设立全资子公司浙江惠芯先进半导体有限公司（暂定名），项目公司注册资本人民币40亿元。

（2）项目名称：惠科先进封装及测试项目（暂定）

（3）项目投资：项目分二期建设。其中项目一期计划建设12寸混合芯片先进封装及测试，全部达产后，达到2000万颗/月产能，预计项目建设周期不超过三年。最终依据批准的项目可行性研究报告/申请报告确定。项目二期根据项目一期实施情况适时启动，项目二期投资方案、规模及启动时间由双方另行协商确定，以届时签署的正式投资协议为准。

3、扶持措施

（1）甲方积极支持项目公司产线建设。

（2）甲方积极协助和支持乙方及项目公司申报国家级、省级、市级、区级的各类荣誉、专项扶持资金配套奖励等。

（3）自本协议签订之日起，对照国家、省、市、区级及甲方层面出台的相关产业政策，甲方承诺协助项目公司在规定范围内享受各类政策。

4、双方承诺

（1）甲方承诺

甲方积极协调项目推进过程中的各类事项，在法律法规、政策的允许范围内，对不存在实质性阻碍事项，给予绿色通道，提供优质、高效、便捷的服务。

（2）乙方承诺

1) 乙方在本协议签订后1个月内在杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区范围内设立全资子公司浙江惠芯先进半导体有限公司（暂定名），作为本项目的建设运营主体公司。在乙方作为项目公司控股股东期间，乙方不得因转让项目公司的股权导致其失去对项目公司的控制。乙方应确保项目公司加入本协议，按照本协议约定履行其合同义务。

2) 项目公司亩均固定资产投资强度具体以项目公司实际投资为准。

3) 项目公司在建设和生产过程中，需符合国家及浙江省相关产业的安全生产和环保要求，乙方将积极协助项目公司满足前述要求。

4) 项目公司在项目建成投产后，原则上十年内不得擅自进行项目变更，因市场情况需要变更的，则需按程序决策后实施。

5、约束条件

（1）甲、乙双方须按照协议约定和有关法律法规规定全面履行协议。任何一方不履行协议或者履行协议不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，直至守约一方获得损失补偿或同意解除协议。

（2）项目公司作为项目实施主体应当加入和履行本协议，并对其行为承担责任。

6、其他条款

（1）履行协议中发生的争议，双方协商解决。协商不成的，依法诉至甲方所在地人民法院。

（2）本合作协议壹式肆份，经甲乙双方签字盖章后生效，双方各执贰份。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司深耕半导体显示领域多年，具备丰富的半导体显示面板研发与制造经验、稳定的客户资源及行业认知。本次投资系围绕公司半导体显示主营业务向上游产业链延伸，有利于完善产业链布局，发挥业务协同效应，提升整体供应链韧性。

先进封装及测试业务与公司现有面板业务在技术路线、客户结构、应用场景等方面具有高度协同性。通过产业链整合，公司能够更好地匹配先进封装及测试与面板产品的技术规格，提升整体解决方案的竞争力。

在全球半导体产业供应链重构及国内芯片封装测试市场需求持续增长的背景下，公司通过本次投资，切入先进封装及测试领域，是公司主动向产业链高附加值环节延伸的重要举措，有利于培育新的业务增长极，优化产业结构，提升公司综合竞争力与长期盈利能力。

2、存在的风险和对公司的影响

（1）项目推进需要一定建设周期，如因有关政策调整、项目核准、市场环境、前沿技术开发等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。项目二期启动需根据项目一期实施情况综合评估后确定，存在一定不确定性。合作协议中提及的产能规模为基于当前情况的阶段性预估，不构成对投资者的实质性业绩承诺。

（2）先进封装及测试项目目前处于前期筹备阶段，尚未完成产线建设，未产生任何量产及营收，预计未来2-3年内，上述业务不会对公司经营业绩产生重大影响。项目后续技术路线验证、工艺开发等实施进度存在重大不确定性。

（3）先进封装及测试领域技术迭代较快，客户最终技术路线选择、市场需求格局及行业竞争态势具有重大不确定性，若公司后续技术研发或客户验证进度不及预期，可能导致项目量产时间延后或预期收益调整。

（4）本项目涉及公司进入新的业务领域，在高端人才引进、核心团队组建及业务管理体系搭建方面需要一定适应期，若相关进展不及预期，可能对项目整体推进效率产生阶段性影响。

（5）本次公司设立全资子公司注册资本为40亿元人民币，资金来源为自有资金。公司预计将在项目公司设立后2-3年内根据项目建设进度需求分期投入，该安排预计将对公司现金流带来一定影响。

公司提醒投资者注意，上述相关风险可能导致本项目最终实现的投资回报与预期存在差异，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第五次临时会议决议；

2、《先进封装及测试项目合作协议》。
特此公告。

惠科股份有限公司
董事会
2026年7月18日